



週間半導体ニュース

2026年8月31日 – 9月6日

SEMICON Taiwan開幕の週。NVIDIAが4日間で164億ドルを投じ、日米は5500億ドル枠の第3弾でAI・半導体を重点化、TSMCの装置需要は昨年12月比1.9倍に膨らんだ。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

Sources: Bloomberg / Reuters / WSJ / CNBC / TechCrunch / DCD / Tom's Hardware ほか

今週の注目



164億ドル
NVIDIAの4日間

Hugging Face買収と
MediaTek出資の合計。
(NVIDIA、9/3)



5500億ドル
**日米の対米投融資
枠**

第3弾はAI・半導体を重点
分野とする方針。
(Bloomberg、9/4)



1.9倍
TSMCの装置需要

昨年12月の自社想定比。AI
需要に追いつかず。
(Bloomberg、9/2)

1. AIチップ・GPU



NVIDIA、MediaTekに35億ドル出資

2031年満期のゼロクーポン転換社債で取得。MediaTekはNVLink Fusionを採用し、カスタムASICをNVIDIAのラックに接続できる。

[\(TechCrunch、8/31\)](#)



Broadcom、AI半導体売上167億ドル

第3四半期売上は過去最高の296億ドル。AI半導体は167億ドルで全社売上の56%を占めた。2028年度のAI売上は約2300億ドルと予想する。

[\(CNBC、9/2\)](#)



SamsungのHBMシェアが33%に急上昇

第2四半期のシェアは21%から33%へ12ポイント上昇。首位SK hynixとの差は37ポイントから17ポイントに縮小した。

[\(Counterpoint、9/3\)](#)



Samsung、DRAM直上積層の「zHBM」構想

Hot Chips 2026で3段階のロードマップを公表。最終段階ではHBM5比でI/O電力約70%減、帯域約2.3倍を見込む。

[\(Tom's Hardware、9/1\)](#)

2. 前工程・サプライチェーン



TSMCの装置需要、昨年12月比1.9倍に

台湾13棟、海外5～6棟のファブを同時建設中だが、それでもAI需要を満たせないとした。通常の同時建設は4～5棟にとどまる。

(Bloomberg、9/2)



SEMI、2028年装置市場を2200億ドルへ

7月時点の約2000億ドルからの上方修正とDigiTimesが報じた。TSMCの2nm量産加速と3nm増強が牽引する。SEMIの公式発表はない。

(DigiTimes、9/1)



ASML、High-NA EUV 10台が稼働

4顧客で稼働し、3台が出荷・設置中。累計露光は135万枚を超えた。将来のDRAM 5世代にも対応可能とした。

(TrendForce、9/1)



HBM3Eスポット価格が契約の4～5倍に

36GB品が約2100ドル、16層HBM4は約3500ドル。Samsungは能力の約7割を2031年までの長期契約で押さえたとされる。

(TrendForce、9/1)

3. コンシューマー向けチップ

-  **NVIDIA「RTX Spark N1X」 10月投入**
20コアGrace CPUと6144コアBlackwell GPUの構成。IFAでASUS・Lenovo・Acerの搭載機が出そろった。
([Tom's Hardware、9/3](#))
-  **Intel「Nova Lake」の投入日程が流出**
第4四半期に量産入りし、28コア版が2027年第1四半期に発売。最大288MBのbLLCでAMDのX3Dに対抗する。
([Tom's Hardware、9/3](#))
-  **A20 Pro、GPU 7コアとメモリ幅拡張か**
GPUは6コアから7コアへ。メモリ幅は64ビットから96ビットへ50%拡張され、端末内推論の帯域が改善する。
([MacRumors、9/3](#))
-  **Lenovo IdeaPad Vibe、699ドルから**
Snapdragon XまたはAMD Ryzen AI 400を搭載。699ドル構成はDRAM高騰で8GBになる公算が大きい。
([Tom's Hardware、9/3](#))

4. ハイパースケーラー・DC・電力



Anthropic、Lambdaと350億ドル契約

テキサス州で開発中の350MWを確保し、当該施設のリースはNVIDIAが保有する。契約済み容量は10GWを超えた。

[\(DCD / WSJ、9/1\)](#)



Meta、アイダホの12億ドル拠点が稼働

同社2カ所目のAI特化拠点。閉ループ液冷で年間の大半は水を使わず、域内に645MWの再エネを追加した。

[\(DCD、9/4\)](#)



カリフォルニア州、DC料金法案を可決

成立版はCPUCに2028年1月までの料金新設を求め、対象閾値の上限を25MWとする。同週ミズーリでは市議がリコールされた。

[\(DCD、9/3\)](#)



SMR、ハイパースケーラーが下支え

初期の商用案件は電力会社調達ではなく三者モデルで進む。制約は炉ではなくサプライチェーンと系統だという。

[\(Utility Dive、9/4\)](#)

5. 自動運転・車載半導体

-  **Waymo、14都市へ拡大し初の負債調達**
3都市を追加し車両は4000台超に。Pimcoなどから30億ドル超を初めて負債で調達する。評価額は1260億ドル。
(TechCrunch・Bloomberg、9/2)
-  **Tesla Cybercab始動、NHTSAが調査**
ハンドルもペダルもない2人乗り。登録はテキサスで45台にとどまる。NHTSAは約1000台を対象に監査を開始した。
(TechCrunch、9/4)
-  **Zoox、ラスベガス空港で初の許可**
ハリー・リード国際空港の2ターミナルで乗降が可能に。無人運転として初の空港許可となった。
(TechCrunch、9/3)
-  **Uber、3300人削減で自動運転に投資**
全社員の10%を削減し、エンジニアリングとデリバリー部門を統合する。配車・配達・ロボタクシーへの投資原資を捻出する。
(TechCrunch、9/2)

6. チップスタートアップ・投資

3億ドル

Gimlet Labs、調達3億ドル・評価額30億ドル

a16zが主導し、ArmとMicrosoftのM12も参加。推論を異種シリコンに分散させる方式を開発する。

([GlobeNewswire](#)、9/4)

35億ドル

Nscale、調達35億ドル・NVIDIAが20億ドル

Third Point主導の転換社債と合わせた調達。自社開示の受注残高は1カ月で倍増し約1030億ドルとされる。

([TechCrunch](#)、9/4)

1億6500万ドル

Lyte、調達1億6500万ドル・評価額16億ドル

Maverick Silicon主導。元Appleの技術者が創業し、ロボット知覚向けの独自シリコンを開発する。

([SiliconANGLE](#)、9/2)

1億2500万ドル

iPronics、調達1億2500万ドル・NVIDIA参加

スペイン発のシリコンフォトニクス企業。可動部のない光回線交換でGPU稼働率の改善を狙う。

([GlobeNewswire](#)、9/2)

7. 業界再編・政策

⚖️ NVIDIA、Hugging Face を買収

買収額は129.3億ドルで、2027年上半期の完了を目指す。うち最大10億ドルは従業員の株式報酬。

(NVIDIA / CNBC、9/3)

⚖️ 米、232条「第2弾」関税 を確認

Lutnick商務長官は米国内生産の有無で免除を判断する方針を認めた。サーバーなどへの対象拡大はPolitico報道による観測。

(ITT、9/3)

⚖️ 日米、5500億ドル枠でAI ・半導体重視

赤沢経産相がラトニック長官らと会談。第3弾はAI・半導体が「非常に大きな比重」を占めるとした。

(Bloomberg、9/4)

⚖️ 台湾200億ドル追加、韓 国も条項主張

台湾の対米投資は累計約550億ドルに。韓国は「劣後しない待遇」が合意文書に明記されたと説明した。

(Reuters・Sedaily、9/2)

出典

本レポートで参照した主な媒体 (2026年8月31日～9月6日公開分)

- TechCrunch
- Bloomberg
- CNBC
- Reuters (via Yahoo Finance)
- WSJ (via Data Center Dynamics)
- Data Center Dynamics
- Tom's Hardware
- Seoul Economic Daily
- TrendForce
- DigiTimes
- Utility Dive
- NVIDIA Newsroom
- AMD Investor Relations
- GlobeNewswire
- SiliconANGLE
- MacRumors
- Focus Taiwan (CNA)
- International Trade Today
- Nikkei / Investing.com
- SIA / BIS / gov.ca.gov